

معرفی و بررسی عملکرد تشدیدگرهای میکرومکانیکی

مهندی راغبی

استادیار گروه مهندسی مکانیک
دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند
raghebi@yahoo.com

محمد ایمان پرست*

مربی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی
شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان
imanparast@eng.usb.ac.ir

مجید باقری

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند
majid.bagheri@birjand.ac.ir

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۱۰/۰۷

چکیده

امروزه با پیشرفت‌های صورت‌گرفته در زمینه ساخت سیستم‌های میکروالکترومکانیکی، قطعات میکرومکانیکی کاربردهای گسترده‌تری یافته‌اند. از جمله این قطعات پرکاربرد، تشدیدگرهای میکرومکانیکی است. تشدیدگرهای میکرومکانیکی ابعادی کوچک و فرکانس‌های تشدید بالایی دارند. امروزه از این تشدیدگرهای میکرومکانیکی در سیستم‌های ارتباطی بی‌سیم و ناوبری، فیلترها، میکروسکوپ‌اتمی، ژیروسکوپ‌های ارتعاشی، حسگرهای جرم، فشار، کرنش، نیرو، شتاب، دما و زیستی استفاده می‌شود. با توجه به اهمیت و کاربرد گسترده تشدیدگرهای میکرومکانیکی، در این مقاله، نخست انواع تشدیدگرهای کاربردهای مزايا، نحوه عملکرد آنها در سیستم‌های ارتعاشی، مواد سازنده و انواع روش‌های تحریک و تشخیص در آنها معرفی پس از آن پارامتر ضریب کیفیت و نحوه محاسبه آن تشریح می‌شود. در ادامه انواع سازوکارهای اتلاف انرژی، مدهای ارتعاشی و پارامتر مقاومت حرکتی در تشدیدگرهای میکرومکانیکی توضیح داده می‌شود و در نهایت مشخصات انواع تشدیدگرهای متداول ارائه می‌گردد.

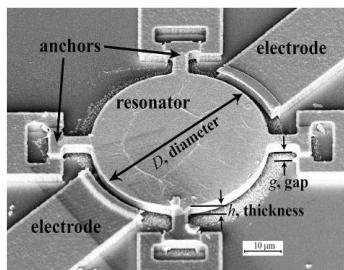
واژگان کلیدی: تشدیدگر میکرومکانیکی، ضریب کیفیت، سازوکار اتلاف انرژی، تحریک و تشخیص، مد ارتعاشی

۱. مقدمه

شتاب‌سنج [۱۴-۱۲] و حسگرهای دما [۱۵] استفاده کرد. همچنین این تشدیدگرهای میکرومکانیکی پتانسیل زیادی برای جایگزینی با کریستال کوارتز برای کاربردهای زمانی و فرکانسی دارند [۱]. فراتر از کاربردهای فرکانسی، ارتباطی از انواع مراجع زمانی و فرکانسی استفاده می‌کنند که تشدیدگرهای میکرومکانیکی با مزایایی چون اندازه کوچک، ایجاد فرکانس‌های بالا با ضریب کیفیت بالا، هزینه ساخت پایین، قابلیت اطمینان و قابلیت ساخت بالا

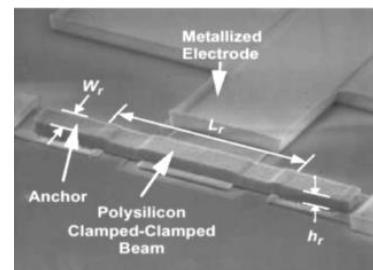
کوتاه‌نوشت MEMS^۱ به معنای سیستم میکروالکترومکانیک است. تشدیدگرهای^۲ میکروالکترومکانیکی پتانسیل زیادی برای جایگزینی با کریستال کوارتز برای کاربردهای زمانی و فرکانسی دارند [۱]. فراتر از کاربردهای فرکانسی، تشدیدگرهای میکروالکترومکانیکی را می‌توان در فیلترها و میکسرها [۲-۳]، میکروسکوپ‌های اتمی [۴]، حسگرهای جرم (بخار، شیمیابی، پروتئین و جز این‌ها) [۴-۵]، حسگرهای فشار [۱۱-۱۰]، حسگرهای کرنش، نیرو و

تشدیدگرهای میکروالکترومکانیکی اغلب سیلیکون‌های یک و چندکریستاله است [۱۸]. سیلیکون دارای خواصی چون عمر مفید طولانی، مقاومت خوب در برابر خستگی، اثر مخرب ناچیز بر طبیعت و حساسیت متوسط به دما می‌باشد [۱۹]. تشدیدگرهای میکرومکانیکی شکل‌های متنوع تیر، دیسکی دایره‌ای^۳، صفحه مربعی^۴، رینگ حلقوی^۵، شانه^۶ و جز این‌ها دارند [۱۷]. در شکل‌های ۱ تا ۷ نمونه‌هایی از تشدیدگرهای میکرومکانیکی نمایش داده شده است.

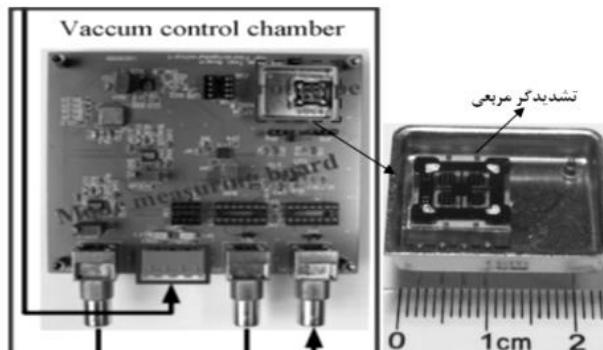


شکل ۲. تشدیدگر دیسکی میکرومکانیکی [۲۱]

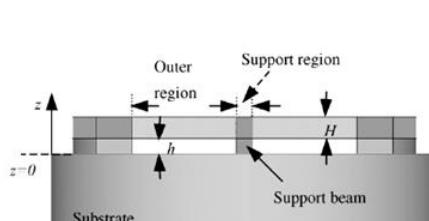
می‌توانند گزینهٔ بسیار مناسبی در این کاربردها باشند. از جمله مزایای عمدۀ تشدیدگرهای میکرومکانیکی توان مصرفی پایین و پاسخ دینامیکی گرمایی خوب این مصرفی پایین و پاسخ دینامیکی گرمایی خوب این تشدیدگرها به علت اندازهٔ کوچک آنهاست [۱]. جنس مواد استفاده شده در سیستم‌های میکروالکترومکانیکی، سیلیکون، پلیمر، طلا، نیکل، الومینیوم، مس، کروم، تیتانیم، تنگستن، پلوتونیم و نقره است، اما جنس مواد مورد استفاده در



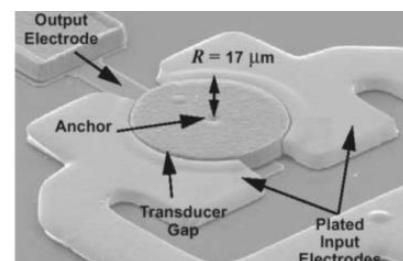
شکل ۱. تشدیدگر تیر گیردار - گیردار سیلیکونی چندکریستاله [۲۰]



شکل ۳. تشدیدگر مربعی میکرومکانیکی با چهار تیر نگهدارنده و نحوه قرارگیری آن [۲۲]

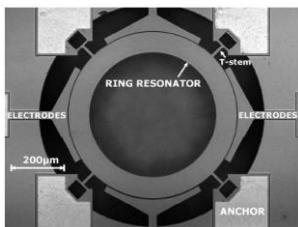


(ب)

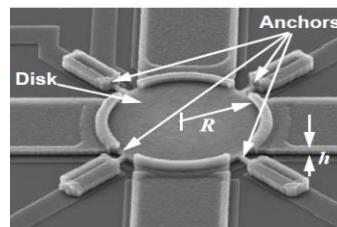


(الف)

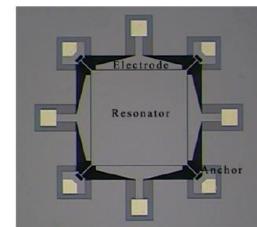
شکل ۴. (الف) تشدیدگر میکروالکترومکانیکی دیسکی ساخته شده از سیلیکون چندکریستاله تحت مد محیطی با تکیه گاه مرکزی [۲۰]، (ب) نمای جانبی تشدیدگر دیسکی [۲۳]



شکل ۷ نمایی از تشدیدگر
حلقوی میکرومکانیکی [۲۶]

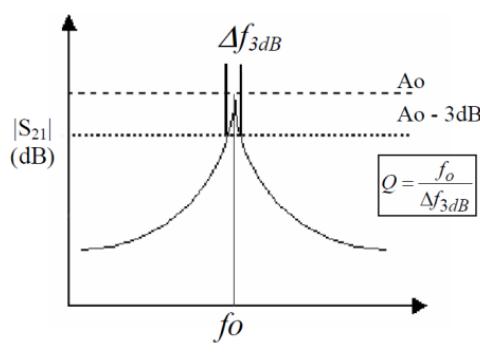


شکل ۶ تشدیدگر دیسکی میکرومکانیکی
با تکیه‌گاه‌های جانبی [۲۵]



شکل ۵ تشدیدگر مربعی میکروالکترومکانیکی
با تیرهای نگهدارنده مایل T شکل [۲۴]

خروجی S_{21} روی محور α مشخص می‌گردد و بحسب دسیبل اندازه‌گیری می‌شود. در بسیاری از حالت‌ها، پارامتر S_{21} با استفاده از رابطه $|S_{21}|_{dB} = 20 \log |S_{21}|$ به دسیبل تبدیل می‌شود. ماکریم فرکانس بعنوان فرکانس تشدید تبدیل می‌شود. مانند f_0 نیازی ندارد. نقاط نصف در نظر گرفته شده و با f_0 مشخص می‌گردد. نقاط نصف توان که برابر با $\max |S_{21}|^{0.5}$ است در دو طرف فرکانس تشدید می‌باشند و اختلاف موقعیت‌های فرکانسی آنها، پنهانی باند $4f$ نام دارد. اگر مقدار $|S_{21}|$ در واحد دسیبل به صورت $|S_{21}|_{dB}$ نشان داده شود، نقاط نصف توان در دو نقطه از منحنی که ۳ دسیبل از مقدار ماکریم فاصله دارند، قرار می‌گیرند [۲۸].



شکل ۸ نحوه محاسبه ضریب کیفیت
براساس اطلاعات موجود در نمودار [۲۸]

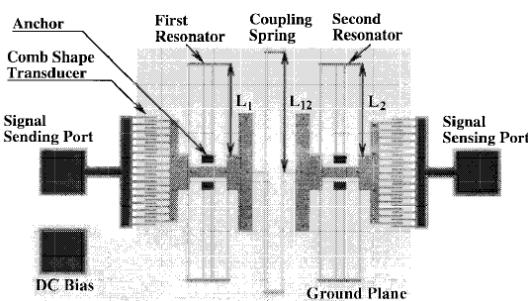
عبارت کلی محاسبه ضریب کیفیت به صورت رابطه ۱ تعریف می‌شود [۱۶]:

$$\frac{1}{Q_{total}} = \sum \frac{1}{Q_{ind}} \quad (1)$$

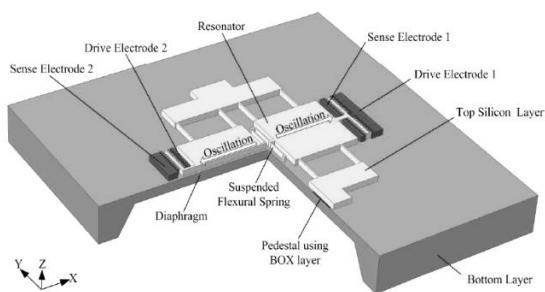
۲. ضریب کیفیت

ضریب کیفیت^۷ شاخصی از سیستم‌های تشدیدی مانند مدارهای RLC است. در چنین مدارهایی انرژی به صورت متناوب تبادل می‌شود که این تبادل به علت وجود مقاومت، با اتلاف انرژی همراه است. در مکانیک، ضریب کیفیت معیاری برای تلفات انرژی یک تشدیدگر است [۲۷]. ضریب کیفیت به صورت نسبت بین انرژی ذخیره شده به انرژی تلف شده در سیستم طی هر سیکل ارتعاش تعريف می‌شود. در فرایندها یا سیستم‌هایی که میزان اتلاف انرژی زیاد است ضریب کیفیت کاهش می‌یابد. تشدیدگرهایی با ضریب کیفیت بالا برای کاربردهای RFMEMS^۸ و حسگرها ضرروری هستند. در کاربردهای حسگری اگر تشدیدگر در معرض ماده شیمیایی باشد، که سبب تغییر در جرم آن شود تغییری در فرکانس تشدید به وجود می‌آید که می‌توان از آن برای شناسایی ماده شیمیایی استفاده کرد. تغییر در فرکانس تشدید نیازمند تشخیص یا احساس تغییر جرم است و زمانی که تشدیدگر دارای ضریب کیفیت بالا باشد به طور دقیق تر تعیین می‌شود. بنابراین حساسیت حسگرها با افزایش ضریب کیفیت افزایش می‌یابد. همچنین ضریب کیفیت بالا برای کاربردهای نوسان‌سازی و فیلتراسیون؛ یعنی جایی که لازم است تا فرکانس به خوبی کنترل شود مطلوب می‌باشد [۲۸]. سیمپیچهای رایج دارای ضریب کیفیتی بین ۲۰ تا ۸۰ هستند، در حالی که خازن‌ها دارای ضریب کیفیت بسیار بیشتر، در حد چندهزار هستند [۲۷]. ضریب کیفیت را می‌توان از روش‌های مختلفی به دست آورد. با توجه به شکل ۸، وقتی تحریک و تشخیص الکترواستاتیک باشد، پارامتر

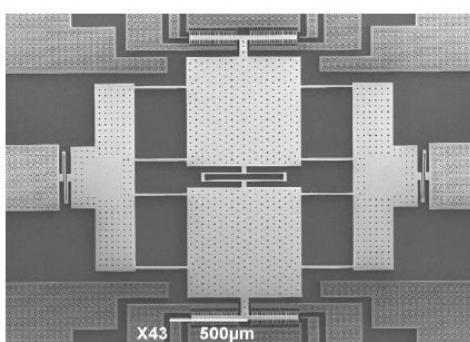
میکرومکانیکی در نظر گرفت. بنابراین برای ارزیابی یک ژیروسکوپ نیاز است تا مشخصات تشیدیدگر بهخوبی بررسی شود. با توجه به این موضوع افزایش ضریب کیفیت باعث بهبود عملکرد ژیروسکوپ خواهد شد [۳۰]. در شکل ۱۲ یک ژیروسکوپ میکرومکانیکی و دو مد تحریک و تشخیص آن نمایش داده شده است.



شکل ۹. نمای شماتیک فیلتر میکرومکانیکی [۲]



شکل ۱۰. نمایی شماتیک از حسگر فشار [۲۹]



شکل ۱۱. حسگر فشار [۲۹]

۴. روش‌های تحریک و تشخیص
دو روش معمول برای تحریک^{۱۳} و تشخیص^{۱۴} در تشیدیدگرهای میکرومکانیکی وجود دارد. روش اول روش

اگر تشیدیدگر دارای اتلاف تکیه‌گاه^{۱۰}، اتلاف هوا^{۱۱}، اتلاف ترمومالاستیک^{۱۲} و اتلاف سطح^{۱۳} و سایر اتلافها باشد، رابطه ضریب کیفیت بهصورت ۲ نوشته خواهد شد [۱۶]:

$$\frac{1}{Q_{total}} = \frac{1}{Q_{anchor}} + \frac{1}{Q_{TED}} + \frac{1}{Q_{air}} + \frac{1}{Q_{surface}} + \frac{1}{Q_{others}} \quad (2)$$

بهطوری‌که در این رابطه Q_{anchor} ضریب کیفیت اتلاف تکیه‌گاه، Q_{TED} ضریب کیفیت اتلاف ترمومالاستیک، Q_{air} ضریب کیفیت اتلاف هوا، $Q_{surface}$ ضریب کیفیت اتلاف سطح و سایر اتلافها با Q_{others} نشان داده می‌شوند.

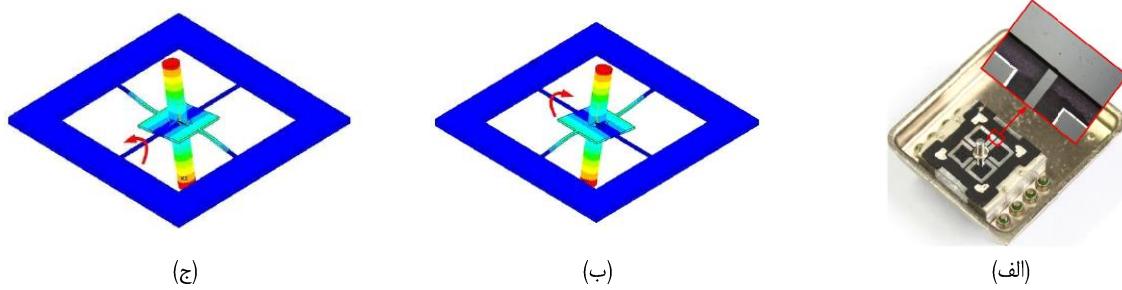
۳. نحوه عملکرد تشیدیدگرهای در سیستم‌های ارتعاشی

زمانی که از تشیدیدگر بهصورت حسگر جرم استفاده می‌شود، بهمحض قرارگرفتن جرم روی آن، در نمودار مربوط به فرکانس تغییر مکان بهوجود می‌آید. با توجه به تغییر مکان صورتگرفته در نمودار مشخص می‌شود که فرکانس سیستم تغییر کرده است و با توجه به ثابتبودن سختی، تغییر جرم تنها نتیجه ممکن خواهد بود و به این صورت تشیدیدگر مورد نظر بهعنوان حسگر جرم عمل می‌کند [۲۱].

فیلترهای میکرومکانیکی از دو تشیدیدگر که توسط تیر به هم متصل شده‌اند ساخته می‌شوند. ضریب کیفیت این تشیدیدگرهای در نحوه عملکرد فیلتر تأثیرگذار است. یک نمونه از این فیلترها در شکل ۹ نمایش داده شده است [۲]. در شکل ۱۰ نمایی شماتیک از حسگر فشار و در شکل ۱۱ یک حسگر فشار از نمایی دیگر نمایش داده شده است. در حسگرهای فشار نیاز است تا تشیدیدگر دارای بالاترین ضریب کیفیت ممکن باشد. بالابودن ضریب کیفیت، حساسیت و وضوح حسگر فشار را افزایش داده و همچنین بهدلیل ساده‌کردن مدار کنترل بازخورد و کاهش نفوذ دخالت‌های خارجی ناخواسته اهمیت بسیاری دارد. برای حذف اثر آشفتگی مدار کنترل بازخورد ضریب کیفیتی بیشتر از ۱۰۰۰ مورد نیاز است [۲۹]. ژیروسکوپ‌های میکرومکانیکی دارای دو مد تحریک و تشخیص هستند. در واقع می‌توان این دو مد را دو مد ارتعاشی یک تشیدیدگر

لیزر است. اگر اندازه نقطه لیزر از ۱ میکرومتر بیشتر شود، اندازه‌گیری سیگنال منعکس شده از سطح تشیدیدگر با ابعاد کوچکتر از ۱ میکرومتر با مشکل مواجه خواهد شد. همچنین لیزر سبب اختلالی مثل ایجاد گرما می‌شود. روش‌های خازنی با مشکلاتی چون پارازیت خازنی مواجه هستند. همچنین در روش خازنی با توجه به اینکه مواد باید رسانا باشند در طراحی دستگاهها و ماده‌ای که در ساخت سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد محدودیت وجود دارد [۲۸].

خازنی (تحریک و تشخیص الکترواستاتیک) و دومین روش ترکیبی از تحریک مکانیکی (تحریک پیزوالکتریک) و تشخیص نوری است. در روش الکترواستاتیک از تغییر در جریان خروجی برای تشخیص حرکت استفاده می‌شود. در روش مکانیکی از تغییر سیگنال نوری (لیزری) منعکس شده از روی سطح تشیدیدگر برای تشخیص حرکت استفاده می‌شود. اما وقتی ابعاد کوچک یا هندسه‌پیچیده‌تر می‌شود سختی استفاده از این دو روش برای تشخیص حرکت اهمیت می‌یابد. مشکل تشخیص نوری، حداقل اندازه نقطه



شکل ۱۲. نمایی از (الف) ژیروسکوپ میکرومکانیکی، (ب) مد تحریک ژیروسکوپ، (ج) مد تشخیص ژیروسکوپ [۳۰]

تیر مرتعش متمرکر می‌گردد و سیگنال منعکس شده برای تعیین فرکانس ارتعاش استفاده می‌شود. تحریک و تشخیص پیزوالکتریک در شکل ۱۵ نمایش داده شده است [۲۸]. فرکانس یک منبع نور با تغییر سرعت منبع نور تغییر می‌کند. سطح بازتابی تشیدیدگر را می‌توان به صورت یک منبع نقطه‌ای در نظر گرفت. این اثر می‌تواند برای تعیین ارتعاشات تشیدیدگر به کار رود. لیزر از نقطه‌ای از سازه تشیدیدگر، که دارای دامنه حرکت ماکریزم است، منعکس می‌شود و به سمت دیود حساس به نور هدایت می‌گردد. برای مثال این نقطه، در یک تیر یک سردرگیر در نوک تیر قرار دارد، بسته به زاویه بین سطح تیر و پرتو لیزر، موقعیت نور منعکس شده در آشکارساز تغییر می‌کند. دیود حساس به نور از این روش وقتی دستگاه ارتعاش می‌کند برای آشکارسازی استفاده می‌نماید. نیروی لازم برای به حرکت درآوردن تشیدیدگر در این روش از مبدل پیزو که باعث لرزش مکانیکی در تشیدیدگر می‌شود، تأمین می‌گردد.

۴-۱. تحریک الکترواستاتیک

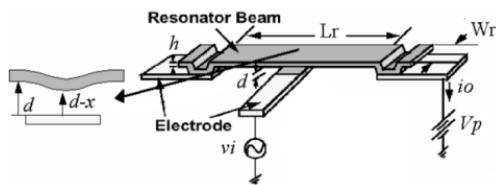
در شکل ۱۳ یک تشیدیدگر تیر نمایش داده شده است. وقتی نیروی الکترواستاتیک استفاده می‌شود، V_p ولتاژ بایاس dC به تیر اعمال می‌شود و ولتاژ ac ورودی $v_i = V_m \sin \omega t$ به الکتروود زیر تیر اعمال می‌گردد. بنابراین پتانسیل الکترواستاتیک در سراسر تیر برابر با $V = V_p + v_i$ است. در یک تشیدیدگر ارتعاشی ظرفیت خازنی بین الکتروود پایینی و تیر با زمان تغییر می‌کند. در نتیجه بار ذخیره شده در خازن با زمان تغییر می‌کند که گردش جریان را به وجود می‌آورد و با استفاده از همین امر می‌توان حرکت تشیدیدگر را تشخیص داد [۲۸]. در شکل ۱۴ نمونه تحریک الکترواستاتیک تشیدیدگر دیسکی میکرومکانیکی نمایش داده شده است.

۴-۲. تحریک پیزوالکتریک و تشخیص نوری

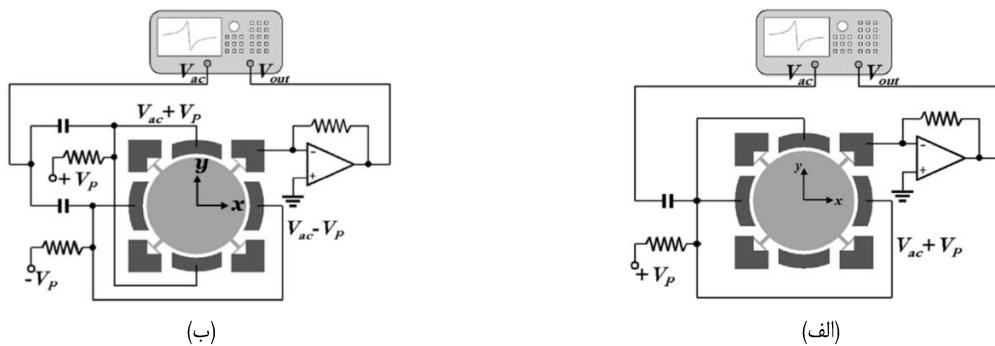
ایده اصلی در روش تحریک پیزوالکتریک تماس فیزیکی تشیدیدگر به مبدل پیزو است. برای تشخیص لیزر، لیزر روی

گردش جریان الکتریکی وجود ندارد و در نتیجه لازم نیست تا نمونه رسانا باشد [۲۸].

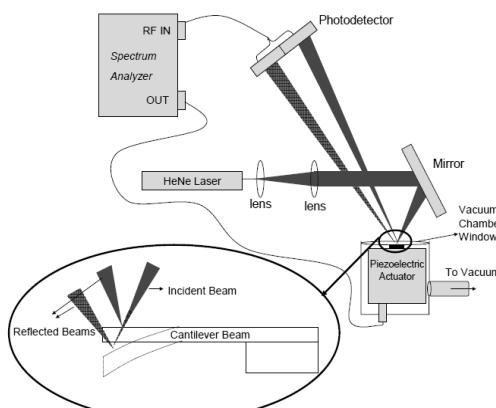
تشخیص توسط آشکارسازی نور منعکس شده از لیزری می باشد که روی تشیدگر متتمرکز شده است. در این روش



شکل ۱۳. تشیدگر تیر که توسط تحریک الکترواستاتیک مورد آزمایش قرار می گیرد [۲۸]



شکل ۱۴. (الف) مدار شماتیک برای تحریک و تشخیص الکترواستاتیک مد شعاعی - محیطی تشیدگر صفحه دیسکی میکرو [۳۱]
ب) مدار شماتیک برای تحریک و تشخیص الکترواستاتیک مد wine glass تشیدگر صفحه دیسکی میکرو [۳۱]



شکل ۱۵. تحریک و تشخیص پیزوالکتریک [۲۸]

نشأت می گیرد که در هنگام تغییر شکل های محلی و لغزش های میکرو، انرژی می تواند از تشیدگر به سازه تکیه گاه منتقل شود. هرچه بتوان صلبیت تکیه گاه را افزایش داد، حرکت تشیدگر در این ناحیه کمتر می شود. نتیجه این کاهش حرکت، کاهش اتلاف تکیه گاه است. اغلب نمی توان صلبیت تکیه گاه را افزایش داد، اما اتلاف انرژی می تواند با

۵. انواع اتلاف انرژی
اتلاف انرژی را می توان به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم کرد.

۱-۵. سازوکارهای خارجی
دو نوع سازوکار خارجی اصلی وجود دارد که عبارتند از اتلاف هوا و اتلاف تکیه گاه. اتلاف تکیه گاه از این واقعیت

پایین منتقل می‌شود. مقداری از انرژی مکانیکی تشدیدگر در حین انتقال جریان دما از دست می‌رود که این پدیده به عنوان اتلاف ترمومالاستیک شناخته می‌شود [۳۳]. همچنین سازوکارهای اتلاف انرژی وجود دارند که به سطح تشدیدگر مرتبط است که به خوبی درک نشده است. در بسیاری از موارد ارتباط خطی بین اتلاف انرژی و نسبت مساحت سطح به حجم مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد ضریب کیفیت با اتلاف سطح محدود می‌گردد [۳۴-۳۶].

۶. مقاومت حرکتی

در محدوده فرکانسی گیگاهرتز تشدیدگرهای میکرومکانیکی با ضریب کیفیت بالا در سیستم‌های ارتباطی، که برای فیلتر فرکانس استفاده می‌شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. در میان مسائل مهم یک مسئله باقی می‌ماند که مانع کاربرد تشدیدگرهای RF می‌شود و آن وجود امپدانس بزرگتر از حد معمول است. بهطور خاص این امپدانس بزرگ که معمولاً مقاومت حرکتی^{۱۵} نامیده می‌شود مانع از این می‌شود که تشدیدگرهای در محدوده وی. اج. اف.^{۱۶} و یو. اج. اف.^{۱۷} برای کوپلینگ مستقیم آتن‌ها در کاربردهای ارتباطی بی‌سیم کاربرد داشته باشند؛ زیرا امپدانس لازم در حدود ۵۰ تا ۳۳۰ اهم است [۳۷]. روش‌هایی برای کاهش مقاومت حرکتی در تشدیدگرهایی که تحریک الکترواستاتیک دارند، وجود دارد که عبارت‌اند از:

۱. کاهش شکاف بین الکترود و تشدیدگر

۲. افزایش ولتاژ بایاس dc

۳. جمع خروجی‌های آرایه تشدیدگرهای یکسان با هم

۷. شکل مدهای ارتعاشی

می‌توان تشدیدگرهای را براساس شکل مدارتعاشی آنها نیز دسته‌بندی کرد: دسته مدهای خمشی^{۱۸}، پیچشی^{۱۹} و حجمی^{۲۰} [۱۷]. در شکل‌های ۱۶ تا ۱۹ بعضی از انواع مدهای ارتعاشی خمشی تشدیدگر مستطیلی میکرومکانیکی با دو تیر افقی نگهدارنده نمایش داده شده است. در مدهای ارتعاشی لغزشی خارج صفحه (شکل ۱۶)، تشدیدگر فقط در

بهینه‌سازی ساختار کاهش یابد [۲۸]. مقدار Q_{support} را می‌توان به صورت رابطه ۳ محاسبه کرد [۳۲]. در این رابطه U انرژی ناشی از ارتعاشات، ΔU کل انرژی تلفشده در هر سیکل نوسان، ω فرکانس تشدید و Π توان خالص جریان انرژی خروجی از تشدیدگر است.

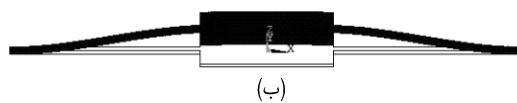
$$Q_{\text{support}} = 2\pi \frac{U}{\Delta U} = \frac{\omega U}{\Pi} \quad (3)$$

اتلاف هوا از انتقال انرژی مکانیکی به گاز اطراف تشدیدگر رخ می‌دهد. بسته به سطح فشاری که در حین تست تشدیدگر وجود دارد، ممکن است اتلاف هوا بر ضریب کیفیت اثر بگذارد. در فشار زیر ۱۰ mtorr اتلاف هوا در مقایسه با اتلاف داخلی تشدیدگر قابل صرفنظر کردن است. چون در این سطح فشار، سازوکارهای داخلی باعث کاهش ضریب کیفیت می‌شوند این رژیم فشار، ناحیه اتلاف درونی نامیده می‌شود. وقتی فشار بین ۱۰ mtorr و ۴ torr باشد، ناحیه مولکولی وجود دارد. در فشار بالاتر از ۴ torr ناحیه ویسکوز است. در این ناحیه هوا به صورت یک سیال ویسکوز عمل می‌کند و اتلاف هوا یک عامل مهم برای کاهش ضریب کیفیت خواهد بود [۲۸].

۵-۲. سازوکارهای داخلی

اتلاف ترمومالاستیک و اصطکاک داخلی می‌توانند به عنوان سازوکارهای اتلاف انرژی داخلی مورد بحث قرار گیرند. سازوکار اتلاف انرژی بر اثر اصطکاک داخلی به نقص در شبکه کریستالی ارتباط دارد. اگر ماده‌ای با ضریب انبساط گرمایی مثبت تحت تأثیر تنفس‌های فشاری قرار گیرد، در آن افزایش دما به وجود می‌آید و وقتی تحت تنش کششی باشد، کاهش دما در آن رخ می‌دهد. وقتی تشدیدگر در مدهای ارتعاشی به‌غیر از مد ارتعاشی پیچشی خالص ارتعاش می‌کند هر دو تنش کششی و فشاری در آن به‌طور همزمان ایجاد می‌شود که سبب ایجاد دو ناحیه می‌گردد که در یک ناحیه افزایش دما و در ناحیه دیگر کاهش دما رخ می‌دهد. با توجه به ایجاد دو ناحیه سردر و گرمتر در تشدیدگر، گرما از ناحیه با دمای بالا به‌سمت ناحیه با دمای

راستای محور z نشان دارد. قسمت ب از شکل ۱۸ نشان می‌دهد که ابعاد تشیدیگر در این مد ارتعاشی نیز تغییر نمی‌کند. در مد ارتعاشی تکان‌دهنده داخل صفحه شکل ۱۹، تیرهای نگهدارنده در صفحه $y-x$ دچار خمش شده‌اند و این خمش سبب دوران تشیدیگر در راستای محور z شده است. قسمت ب از شکل ۱۹ نشان می‌دهد ابعاد تشیدیگر در این مد ارتعاشی هم تغییر نمی‌کند. در شکل ۲۰ مد پیچشی تشیدیگر مستطیلی میکرومکانیکی با دو تیر افقی نگهدارنده نمایش داده شده است.



(ب)

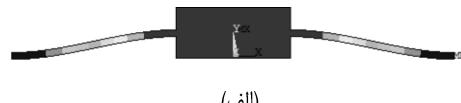
شکل ۱۶. (الف) مد ارتعاشی لغزشی خارج صفحه^{۲۱} (مد شناور) تشیدیگر مستطیلی میکرومکانیکی با دو تیر افقی نگهدارنده (نمای جانبی)
ب) نحوه تغییر شکل در مد ارتعاشی لغزشی خارج صفحه (نمای جانبی) [۳۸]



(الف)

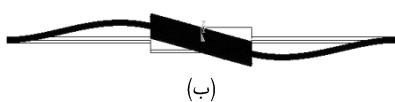


(ب)

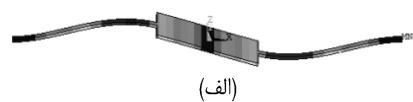


(الف)

شکل ۱۷. (الف) مد ارتعاشی لغزشی داخل صفحه^{۲۲} تشیدیگر مستطیلی میکرومکانیکی با دو تیر افقی نگهدارنده (نمای بالا)
ب) نحوه تغییر شکل تشیدیگر در مد ارتعاشی لغزشی داخل صفحه (نمای بالا) [۳۸]



(ب)



(الف)

شکل ۱۸. (الف) مد ارتعاشی تکان دهنده خارج صفحه^{۲۳} تشیدیگر مستطیلی میکرومکانیکی با دو تیر افقی نگهدارنده (نمای جانبی)
ب) نحوه تغییر شکل تشیدیگر در مد ارتعاشی تکان دهنده خارج صفحه (نمای بالا) [۳۸]

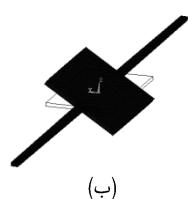


(ب)

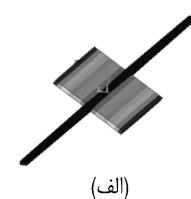


(الف)

شکل ۱۹. (الف) مد ارتعاشی تکان دهنده داخل صفحه^{۲۴} تشیدیگر مستطیلی میکرومکانیکی با دو تیر افقی نگهدارنده (نمای بالا)
ب) نحوه تغییر شکل تشیدیگر در مد ارتعاشی تکان دهنده داخل صفحه (نمای بالا) [۳۸]



(ب)



(الف)

شکل ۲۰. (الف) مد ارتعاشی پیچشی پیچشی تشیدیگر مستطیلی میکرومکانیکی با دو تیر افقی نگهدارنده (نمای جانبی)
ب) نحوه تغییر شکل تشیدیگر در مد ارتعاشی پیچشی (نمای جانبی) [۳۸]

۱-۹. تشدیدگر شانه‌ای

این تشدیدگر به گونه‌ای طراحی شده است که ضربیت بالای دارد؛ به طوری که حتی ضربیت کیفیت آن از تشدیدگر تیر دو سر آزاد نیز بیشتر است (مانند ضربیت کیفیت ۱۰۰۰۰ در فشار هواي $\text{m} \text{torr}$). اما این نوع تشدیدگر تمایل دارد تا در محدوده فرکانسی پایین (در حدود کیلوهرتز) ارتعاش کند. این امر به دلیل ساختار بزرگ این تشدیدگرها و جرم بالاست. به دلیل ساختار پیچیده این تشدیدگر امکان کاهش جرم آن راحت نیست [۲۸].

۲-۹. تشدیدگر تیر گیردار - گیردار

ایده استفاده از تشدیدگر تیر گیردار - گیردار افزایش فرکانس تشدید با داشتن ضربیت کیفیت بالای ۱۰۰۰ می باشد. دو طرف تشدیدگر، گیردار است و تشدیدگر از طریق الکتروودتاتیک تحریک می شود [۴۱].

۳-۹. تشدیدگر خمشی تیر آزاد - آزاد

سختی بزرگ تیر گیردار - گیردار سبب افزایش اتفاق تکیه‌گاه می شود که نتیجه آن کاهش ضربیت کیفیت است. برای رفع این مشکل تشدیدگر خمشی تیر آزاد - آزاد استفاده شده است که دارای محدوده فرکانسی ۳۰ تا ۹۰ مگاهرتز و ضربیت کیفیت بالای ۸۴۰۰ است [۴۱]. این تشدیدگر شامل یک تیر آزاد - آزاد است که در چهار نقطه خمشی توسط چهار تیر پیچشی نگهداری می شود و هر کدام از تیرها به زیر لایه متصل‌اند. تشدیدگر تیر آزاد - آزاد در نقاط گرهی تیر نگهداری می شود. در نقاط گرهی حرکت وجود ندارد. ضربیت کیفیت در حالت گیردار با کاهش طول تیر کاهش می یابد. اگر سازوکار اصلی اتفاق اثری اتفاق تکیه‌گاه باشد، در تیر یک سر گیردار مقدار ضربیت کیفیت با افزایش فرکانس تشدید کاهش می یابد. در تشدیدگر تیر آزاد - آزاد مقدار ضربیت کیفیت با فرکانس تغییر نمی کند.

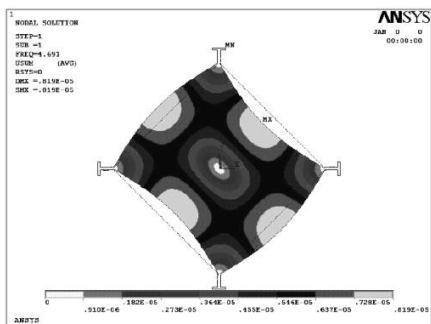
مدهای حجمی در مقایسه با سایر مدها فرکانس‌های بالاتری دارند و این امر به علت بزرگ‌تر بودن سختی این مدها نسبت به سایر مدها است. همچنین مدهای حجمی در فرکانس یکسان ضربیت کیفیت بالاتری نسبت به مدهای خمشی دارند. نرخ سطح به حجم در مدهای خمشی نسبت به مدهای حجمی بالاتر است و بالاتر بودن نرخ سطح به حجم سبب افزایش اتفاق اثری از طریق سطح می شود. لذا مدهای خمشی ضربیت کیفیت پایین‌تری نسبت به مدهای حجمی دارند. یک مثال معمول مدهای حجمی در تشدیدگر دیسکی میکرومکانیکی مشاهده می شود. تشدیدگر دیسکی می‌تواند در دو مد مجزا حجمی ارتعاش کند. اول مد شعاعی - محیطی^{۲۵} (یا مد کششی^{۲۶} یا مد تنفس^{۲۷}). این مد زمانی اتفاق می‌افتد که ابعاد سطح به طور مساوی یکدیگر و در تمام جهات تغییر کند. دوم مد بیضوی^{۲۸} یا wine glass. این مد زمانی رخ می‌دهد که ابعاد تشدیدگر فقط در یک جهت تغییر کند و در این مد تشدیدگر به صورت دو بیضی متناوب و عمود بر هم که دارای چهار نقطه گرهی^{۲۹} هستند در یک سیکل ارتعاش می‌کند. این دو مد تشدیدگر دیسکی میکرومکانیکی در شکل ۲۱ نمایش داده شده است [۱۷]. در شکل‌های ۲۲ تا ۲۸ نیز چند نوع مد حجمی تشدیدگرهای مختلف نمایش داده شده است.

۸. سازه تشدیدگر میکرومکانیکی

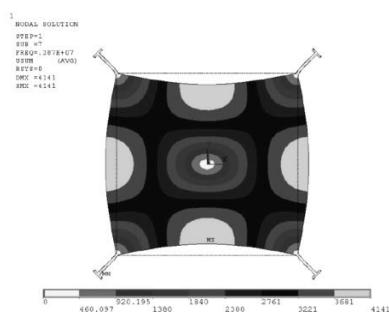
سه روش برای افزایش فرکانس تشدید و ضربیت کیفیت یک تشدیدگر میکرومکانیکی وجود دارد که عبارت‌اند از [۲۸]: استفاده از موادی با خواص الستیک بالاتر، استفاده از هندسه تشدیدگر و کاهش ابعاد تشدیدگر. محققان از ترکیب این سه روش استفاده می‌کنند تا به تشدیدگری با عملکرد منحصر به‌فرد دست یابند.

۹. خصوصیات تشدیدگرهای

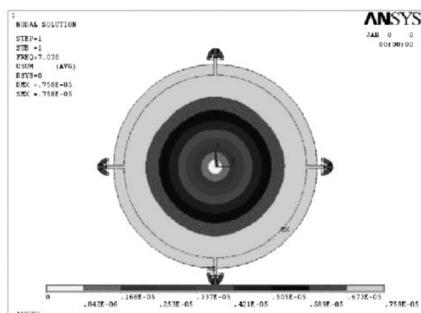
در این قسمت برخی از انواع تشدیدگرهای خصوصیات آنها مورد بحث قرار می‌گیرد.



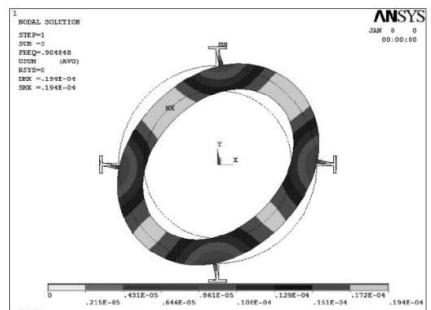
شکل ۲۲. مد تشدیدگر مربعی wine glass دارای تیرهای T شکل [۳۹]



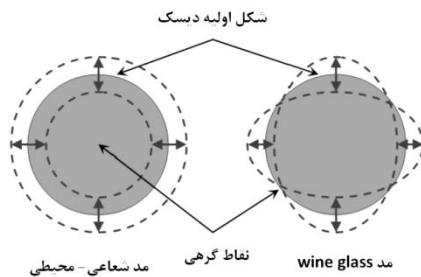
شکل ۲۴. مد تشدیدگر مربعی Lame دارای تیرهای T شکل [۲۴]



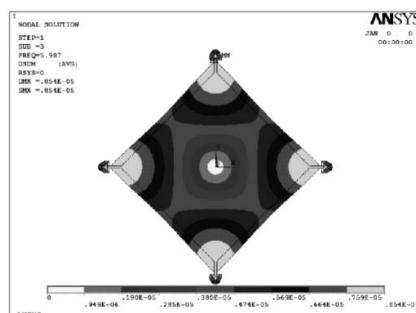
شکل ۲۶. مد کششی تشدیدگر دیسکی میکرومکانیکی دارای تیرهای T شکل [۴۰]



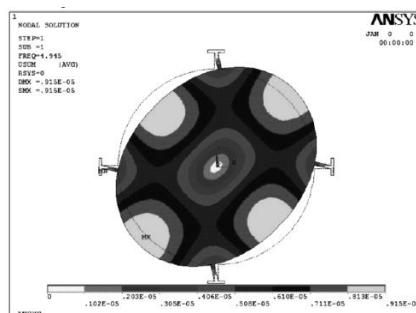
شکل ۲۷. مد بیضوی تشدیدگر حلقوی میکرومکانیکی دارای تیرهای T شکل [۲۶]



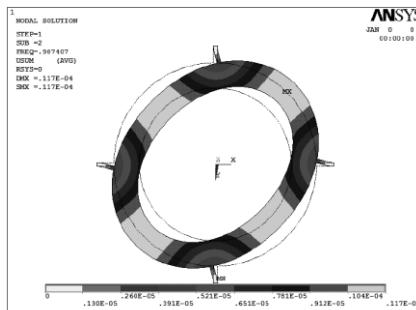
شکل ۲۱. دو نوع مدد حجمی تشدیدگر دیسکی میکرومکانیکی [۱۷]



شکل ۲۵. مدد کششی تشدیدگر مربعی میکرومکانیکی دارای تیرهای T شکل [۴۰]



شکل ۲۸. مدد بیضوی تشدیدگر حلقوی میکرومکانیکی دارای تیرهای T شکل [۲۶]



شکل ۲۹. مدد بیضوی تشدیدگر حلقوی میکرومکانیکی دارای تیرهای مستقیم [۲۶]

۴-۹. تشدیدگر پیچشی

تشدیدگرهای پیچشی می‌توانند در مد پیچشی عمل کنند که این امر سبب می‌شود فرکانس تشدید آنها به جای مدول یانگ به مدول برشی بستگی داشته باشد. وقتی این تشدیدگر مرتعش می‌شود، فقط دچار پیچش خالص شده و تنش‌های کششی یا فشاری در این مد اتفاق نمی‌افتد. حذف مناطق کششی و فشاری از ساختار باعث می‌شود جریان گرما از ساختار عبور نکند و در نتیجه در این مد، اتلاف ترمولاستیک رخ نمی‌دهد. محدودیت این تشدیدگر داشتن تنها یک مد ارتعاشی است و اینکه فرکانس‌های تشدید برای یک دستگاه خاص به یک فرکانس محدود شده است. علت بالابودن ضریب کیفیت مد پیچشی نسبت

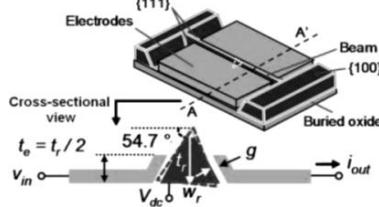
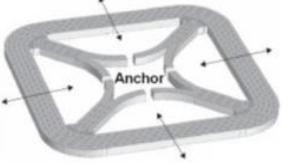
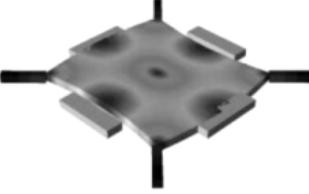
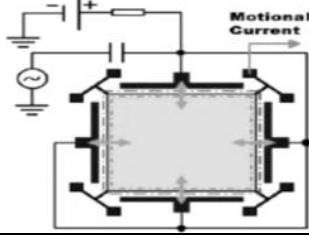
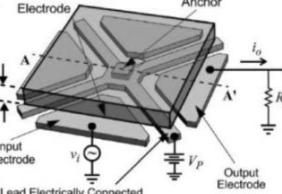
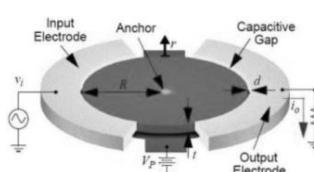
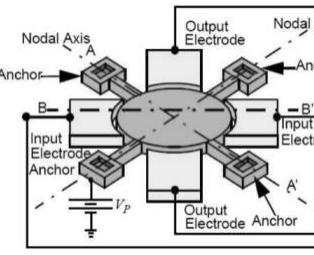
به مد خمسی داشتن اتلاف تکیه‌گاه خیلی پایین و اتلاف فشار فیلم پایین‌تر است [۲۸].

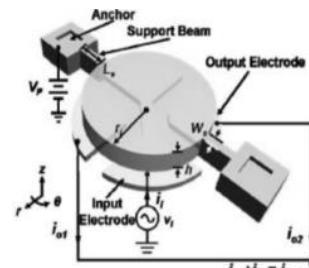
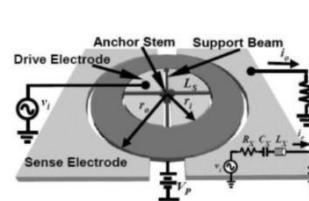
۵-۹. تشدیدگر دیسکی مد شعاعی-محیطی

در کاربردهای RF نیاز به فرکانس‌هایی در محدوده یو. اچ. اف. است و این امر مستلزم داشتن تشدیدگرهایی با ابعاد کوچکتر و سختی بیشتر است تا به ضریب کیفیت بالا دست پیدا کنند. با استفاده از تشدیدگر دیسکی مد شعاعی-محیطی می‌توان با حفظ ابعاد نسبتاً بزرگ به فرکانس‌های بالا دست پیدا کرد [۴۱]. در جدول ۱ به طور خلاصه برخی از انواع تشدیدگرهای به همراه شکل و مشخصات آنها معرفی شده است.

جدول ۱. تصویر، نام و مشخصات برخی از انواع تشدیدگرهای

مشخصات [۱۷]	نام	شکل تشدیدگر
در فرکانس ۳۲ کیلوهرتز ضریب کیفیت ۵۰۰۰۰ و مقاومت حرکتی ۴۲۰ کیلو اهم، ولتاژ بایاس dc برابر ۲/۵ ولت و شکاف ۱ میکرومتر می‌باشد	میکروشکاف دیسکی	
در فرکانس ۹/۳۴ مگاهرتز دارای ضریب کیفیت ۳۱۰۰، مقاومت حرکتی ۸/۲۷ کیلو اهم، ولتاژ بایاس dc برابر ۸ ولت و شکاف ۱۰۰ نانومتر است	میکروشکاف دیسکی	
در فرکانس ۸۰ کیلوهرتز دارای ضریب کیفیت ۷۴۰۰۰ و در نمونه‌ای دیگر در فرکانس ۳/۲ مگاهرتز دارای ضریب کیفیت ۴۵۰۰ می‌باشد. در هر دو نمونه شکاف ۸۰ نانومتر است	میکروشکاف دیسکی	
در فرکانس ۹۲ مگاهرتز ضریب کیفیت ۷۴۵۰ بوده و مقاومت حرکتی آن ۱۶۷ کیلو اهم و ولتاژ بایاس dc برابر ۷۶ ولت می‌باشد	میکروشکاف دیسکی	

مشخصات [۱۷]	نام	شکل تشدیدگر
در فرکانس ۲۰ مگاهرتز دارای ضریب کیفیت ۲۲۰۰۰، مقاومت حرکتی ۱۲ کیلو اهم، ولتاژ بایاس dc برابر ۱ ولت و شکاف ۱۳۰ نانومتر می‌باشد	تشدیدگر پیشی شکل بهمودرت تیر مانند است	
این تشدیدگر در فرکانس ۵/۱ مگاهرتز دارای ضریب کیفیت ۸۰۰۰، ولتاژ بایاس dc برابر ۴/۶ ولت می‌باشد	تشدیدگر مربعی بدجنبی	
این تشدیدگر در فرکانس ۱۷۳ مگاهرتز دارای ضریب کیفیت ۹۳۰۰ و مقاومت حرکتی ۱۸ کیلو اهم و شکاف ۱۹۵ نانومتر است	تشدیدگر لامه	
در فرکانس ۲/۱۸ مگاهرتز دارای ضریب کیفیت ۱۱۶۰۰۰ و ولتاژ بایاس dc برابر ۶۰ ولت و شکاف ۳ میکرومتر می‌باشد	کششی با تیرهای T شکل	
در فرکانس ۶۸ مگاهرتز دارای ضریب کیفیت ۱۵۰۰۰، مقاومت حرکتی ۱۳/۵ کیلو اهم، ولتاژ بایاس dc برابر ۲۵ ولت و شکاف ۹۰ نانومتر می‌باشد	تشدیدگر دو قطبی	
در فرکانس ۱۵۶ مگاهرتز دارای ضریب کیفیت ۹۲۹۰، مقاومت حرکتی ۱۰۰ کیلو اهم، ولتاژ بایاس dc برابر ۳۵ ولت و شکاف ۱۰۰ نانومتر است	تشدیدگر متعادلی	
در حالتی که ماده سازنده پلی‌سیلیکون باشد، در فرکانس ۶۰ مگاهرتز دارای ضریب کیفیت ۴۸۰۰۰ است. مقاومت حرکتی آن ۱/۵ کیلو اهم، ولتاژ بایاس dc برابر ۱۲ ولت و شکاف ۸۰ نانومتر است. در حالتی که ماده سازنده سیلیکون تک‌کریستاله باشد، در فرکانس ۵/۴۳ مگاهرتز دارای ضریب کیفیت ۱۹۰۰۰۰ بوده، مقاومت حرکتی آن ۱۷ کیلو اهم، ولتاژ بایاس dc برابر ۶۰ ولت و شکاف ۲/۷ میکرومتر است	تشدیدگر دیسکی مد جنبی wine glass	

مشخصات [۱۷]	نام	شکل تشدیدگر
در فرکانس $11/6$ مگاهرتز دارای ضریب کیفیت 1651 ، مقاومت حرکتی 22 کیلو اهم، ولتاژ بایاس dc برابر 5 ولت و شکاف 200 نانومتر می باشد	مدهای خمی با پایه همراه	
در فرکانس $1/2$ گیگاهرتز دارای ضریب کیفیت 15000 ، مقاومت حرکتی 274 کیلو اهم، ولتاژ بایاس dc برابر 10 ولت و شکاف 100 نانومتر است	مدهای خمی با پایه جدا	

فرکانسی و ضریب کیفیت آنهاست. برای مثال در این مقاله نشان داده شد که مدهای حجمی به مراتب دارای فرکانس طبیعی بالاتری نسبت به مدهای خمی و پیچشی هستند. بنابراین اگر طراح بخواهد در محدوده فرکانس‌های ارتعاشی بالا طراحی خود را انجام دهد، بهتر است از مدهای حجمی استفاده کند. استفاده از این مقاله، از منابع متعددی استخراج شده است، برای آشنایی و آغاز تحقیق درباره تشدیدگرهای میکرومکانیکی سودمند خواهد بود.

۱۰. نتیجه‌گیری

در این مقاله مباحث مختلف در مورد تشدیدگرهای میکرومکانیکی مورد بحث قرار گرفته است. از جمله مباحث مهم در کاربرد این تشدیدگرهای شناسایی آنها، خصوصیات و انواع مدهای ارتعاشی تشدیدگرهای میکرومکانیکی است، که به آن پرداخته شده است. مقاله حاضر در جهت طراحی تشدیدگرهای دید خوبی ایجاد می‌کند؛ زیرا گام نخست برای طراحی تشدیدگرهای آشنایی با انواع آنها، خصوصیات

۱۱. مأخذ

- [1] Jha, C. M., "Thermal and mechanical isolation of ovenized MEMS resonator", PhD Thesis, Stanford University, 2008.
- [2] Lin, L., R. T. Howe, A. P. Pisano. "Microelectromechanical filters for signal processing." *Journal of Microelectromechanical Systems*, vol. 7, 1998, pp. 286-294,
- [3] Nguyen, C. T.-C. "Microelectromechanical devices for wireless communications." *MEMS 98*, 11th Annual International Workshop on Micro Electro Mechanical Systems, Heidelberg, Germany, 1998.
- [4] Zhong, Q., D. Inniss, K. Kjoller, V. B. Elings. "Fractured polymer/silica fiber surface studied by tapping mode atomic force microscopy." *Surface Science*, vol. 290, 1993, pp. 688-692.
- [5] Buser, R. A., N. F. de Rooij. "Resonant silicon structures." *Sensors and Actuators*, vol. 17, 1989, pp. 145-154.

- [6] Stemme, G. "Resonant silicon sensors." *Journal of Micromechanics and Microengineering*, vol. 1, 1991, pp. 113.
- [7] Kleiman, R. N., G. K. Kaminsky, J. D. Reppy, R. Pindak, D. J. Bishop. "Single-crystal silicon high-Q torsional oscillators." *Review of Scientific Instruments*, vol. 56, 1985, pp. 2088-2091.
- [8] R. T. Howe, R. S. Muller. "Resonant-microbridge vapor sensor." *IEEE Transactions on Electron Devices*, vol. 33, 1986, pp. 499-506.
- [9] Burg, T. P., A. R. Mirza, N. Milovic, C. H. Tsau, G. A. Popescu, J. S. Foster, S. R. Manalis. "Vacuum-Packaged Suspended Microchannel Resonant Mass Sensor for Biomolecular Detection." *Journal Microelectromechanical Systems*, vol. 15, 2006, pp. 1466-1476.
- [10] Parsons, P., A. Glendinning, D. Angelidis. "Resonant sensors for highaccuracy pressure measurement using silicon technology." presented at *National Aerospace and Electronics Conference*, NAECON, Proceedings of the IEEE 1992.
- [11] Stemme, E., G. Stemme. "A Balanced Resonant Pressure Sensor." *Sensors and Actuators A: Physical*, 1990, vol. 21, pp. 336-341.
- [12] Greenwood, J. C. "Silicon in mechanical sensors." *Journal of Physics E: Scientific Instruments*, 1988, pp. 1114-1128.
- [13] Roessig, T. A. W. "Integrated MEMS Tuning Fork Oscillators for SensorApplications", thesis in Mechanical Engineering at University of California, Berkeley, 1998.
- [14] Kim, H. C., S. Seok, I. Kim, S.-D. Choi, K. Chun. "Inertial-Grade Out-of- Plane and In-Plane Differential Resonant Silicon Accelerometers (DRXLs)." presented at TRANSDUCERS '05, Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems, Seoul, 2005.
- [15] Hsu, W.T., J. R. Clark, C. T.-C. Nguyen. "A resonant temperature sensor based on electrical spring softening." presented at TRANSDUCERS '01 / Eurosensors XV, The 11th International Conference on Solid-State Sensors and Actuators, Munich, Germany, 2001.
- [16] Khine, L., "Performance Parameters of Micromechanical Resonators", PhD Thesis, National University of Singapore, 2010.
- [17] Basu, J., T. K. Bhattacharyya. "Microelectromechanical Resonators for Radio Frequency Communication Applications." *Microsystem Technologies*, vol 17 (10-11), 2011, pp.1557-1580.
- [18] Wikipedia, <http://en.wikipedia.org> (accessed August 30, 2016)
- [19] Kaajakari, V., *Theory and Analysis of MEMS Resonators*.
- [20] Gualdino, A., V. Chu, J. P. Conde. "Multi-modal analysis of out-of-plane vibration modes of thin-film circular resonators for mass sensing applications", *Procedia Engineering* 47, 2012, pp. 1121-1124.
- [21] Wang, X., D. Xiao, Z. Zhou, Z. Chen, X. Wu, S. Li. "Support loss for beam undergoing coupled vibration of bending and torsion in rocking mass resonator." *Sensors and Actuators A* 171, 2011, pp. 199-206.
- [22] Hao, Z., F. Ayazi. "Support loss in the radial bulk-mode vibrations of center-supported micromechanical disk resonators." *Sensors and Actuators A*, vol. 134, 2007, pp. 582-593.

- [23] Wu, G., D. Xu, B. Xiong, Y., Wang. "A high Q micromachined single crystal silicon bulk mode resonator with pre-etched cavity." *Microsystem Technologies*, 2011.
- [24] Abdelmoneum, M. A., M. U. Demirci, C. T. C. Nguyen. "Stemless wine glass mode disk micromechanical resonator", Proceedings of the 16th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems, Kyoto, Japan, Jan 2003, pp. 698-701.
- [25] Lee, J. E.Y., J. Yan, A. A. Seshia. "Anchor Limited Q in Flexural Mode Resonators", *Ultrasonics Symposium*, 2008.
- [26] Wikipedia, "quality factor", <https://wikipedia.org> (accessed August 30, 2016).
- [27] Alancastro, N. S. "polycristaline diamond RF MEMS resonator technology and characterization", PhD Thesis, Stanford University, 2005.
- [28] Ren, S., Yuan, W., Qiao D., Deng, J., Sun, X. "A Micromachined Pressure Sensor with Integrated Resonator Operating at Atmospheric Pressure." *Sensors*, vol. 13, 2013, pp. 17006-17024.
- [29] Wang, X., Xiao, D., Zhou Z., Wu, X., Chen, Z., Li, S. "Support Loss and Q Factor Enhancement for a Rocking Mass Microgyroscope." *Sensors*, vol. 11, 2011, pp. 9807-9819.
- [30] Lee, J. E.Y., A. A. Seshia. "5.4-MHz single-crystal silicon wine glass mode disk resonator with quality factor of 2 million." *Sensors and Actuators A: Physical*, vol 156, 2009, pp. 28-35.
- [31] Judge, J. A., D. M. Photiadis, J. F. Vignola, B. H. Houston, J. Jarzynski. "Attachment loss of micromechanical and nanomechanical resonators inthe limits of thick and thin support structures." *Journal of Applied Physics*, Vol. 101, No. 1, 2007, pp. 1-11.
- [32] Czaplewski, D., J. P. Sullivan, T. A. Friedmann, D. W. Carr, B. E. N. Keeler, J .R. Wendt. "Experimental demonstration of a laterally deformable optical nanoelectromechanical system grating transducer." *J. Appl. Phys.* 97, 2005.
- [33] Carr, D. W. "Nanoelectromechanical Resonators", Ph.D. thesis, Cornell University, 2000.
- [34] Blom, F. R., S. Bowstra, M. Elwenspoek, J. H. J Fluitman. "Dependence of the quality factor of micromachined silicon beam resonators on pressure and geometry." *j. Vac. Sci. Technol B* 10(1), Jan/Feb 1992.
- [35] Yasumura, K. Y., T. D. Stowe, E. M. Chow, T. Pfafman, T. W. Kenny, B. C. Stipe, D. Rugar. "Quality factors in micron-and submicron-thick cantilevers." *Journal Microelectromech Sys*, vol. 9(1) Mar. 2000, 117.
- [36] Demirci, M. U., M. A. Abdelmoneum, C. T.-C. Nguyen. "Mecanically corner-coupled square microresonator array for reduced series motional resistance." *IEEE Transducers, Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems*, 12th International Conference, vol. 2, June 9 12, 2003.
- [37] Urey, H., C. Kan, W. O. Davis. "Vibration mode frequency formulae for micromechanical scanners." *Journal of Micro-Mechanics and Microengineering*, vol. 15, 2005, pp. 1713–1721.
- [38] Lee, J. E-Y., J. Yan, A. A. Seshia. "Low loss HF band SOI wine glass bulk mode capacitive square-plate resonator." *Journal of Micro-Mechanics and Microengineering*, vol. 19, 2009, pp. 1-10.
- [39] Lee, J. E-Y., J. Yan, A. A. Seshia. "Study of lateral mode SOI-MEMS resonators for reduced anchor loss." *Journal of Micro-Mechanics and Microengineering*, vol. 21, 2011, pp. 1-10.

[40] Sutagundar, M., B. G. Sheepamatti, D. S. Jangamshetti. "Research Issues in MEMS Resonators." *International Journal of Engineering And Science*, Vol. 4, Issue 8, August 2014, pp. 29-39.

پی‌نوشت

-
- 1. microelectromechanical systems
 - 2. resonators
 - 3. circular disks
 - 4. square plates
 - 5. annular rings
 - 6. comb
 - 7. quality factor
 - 8. radio frequency microelectromechanical system
 - 9. anchor losses
 - 10. air damping
 - 11. thermoelastic dissipation
 - 12. surface loss
 - 13. actuation
 - 14. sensing
 - 15. motional resistance
 - 16. very high frequency
 - 17. ultra high frequency
 - 18. flexural mode
 - 19. torsion mode
 - 20. bulk mode
 - 21. out of plane sliding mode
 - 22. in plane sliding mode
 - 23. out of plane rocking mode
 - 24. in plane rocking mode
 - 25. radial-contour mode
 - 26. extensional mode
 - 27. breathing mode
 - 28. elliptical mode
 - 29. nodal points